

チップ外観検査装置Vi-2200発売 ～ICチップや精密電子部品の微小な異物や欠陥を高速・全自動で検査～

本装置は、新開発の顕微鏡光学系と高速高精度なパターンマッチング画像処理技術により、ICチップや電子部品の微小な異物や欠陥を検出する装置です。良品学習と欠陥検出を行うアルゴリズム及び、新開発の大量データ高速演算ハードウェアを用いて、検査ステージ上にセットされた被検物を自動的に検査し、チップ単位での合否判定を行い、不良チップの位置情報を管理し、製造工程の高度化に貢献します。

【主な用途】

ICウエーハ最終検査
IC組立の受入検査
電子デバイスの外観・形状検査
製造部門での工程不良解析

【特長】

－視野 2.5mm 角を 0.3 秒と高速検査
新開発の「最適化 MIN-MAX 法アルゴリズム」(注1)と高感度の光学系によりメモリ回路のような複雑な回路の中でも 5 μ m サイズまでの欠陥を検出(光学倍率を上げることによりさらに微少欠陥の検出可能)
視野内は、最大 64 個の複数チップを同時に検査
専用検出光学系により、最適な分解能と深い焦点深度を実現
ウエーハ状態では 8 インチまで、ダイシング後のフィルムキャリア付きの状態では 6 インチまで、1 台で両方共対応

(注1) 1 画素内を分解したサブ画素の位置ずれによるノイズを、局所的に位置合わせしながら除去し、S/N比の高い差分演算を行い、検出精度を向上させることにより、誤検出をなくす方法。

【主な仕様】

検査倍率 : 5倍(選択可能)
欠陥検出 : 約5 μ m以上
検査視野 : 2.45mm × 2.45mm
検査時間 : 0.3sec/ 1 視野
占有面積 : 1,580mm(W) × 1,030mm(D)
オプション : プリンター、インクマーカー、無停電電源装置等2

- 【価格】** 5,000～6,000万円（仕様・構成による）
- 【発売時期】** 1999年12月1日
- 【販売予定台数】** 50台/年